

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁵ G11B 5/31	(11) 공개번호 특 1991-0017367
	(43) 공개일자 1991년 11월 05일
(21) 출원번호	특 1991-0003579
(22) 출원일자	1991년 03월 06일
(30) 우선권주장	9000546 1990년 03월 09일 네덜란드(NL)
(71) 출원인	엔.브이.필립스 글로아이라펜파브리켄 프레데릭 얀 스미트 네덜란드왕국, 아인드호펜, 그로네보드세베그 1
(72) 발명자	게라르두스 헨리쿠스 요한누스 소머즈 네덜란드왕국, 아인드호펜, 그로네보드세베그 1 안토니우스 베르나르드 보르만스 네덜란드왕국, 아인드호펜, 그로네보드세베그 1
(74) 대리인	이병호, 최달용

심사청구 : 없음

(54) 박막 자기헤드 및 그 생산방법

요약

내용 없음

대표도

도 1

명세서

[발명의 명칭]

박막 자기헤드 및 그 생산방법

[도면의 간단한 설명]

제1도 내지 제3도는 본 발명에 따른 방법동안의 중간 생성물의 단면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

박막 자기 헤드 생산 방법으로서, 캐리어에서 시작하여 그 위에 제1의 절연층을 흡착하고, 그 위에 플렉스 전도체와 적어도 상기 플렉스 전도체 사이에 제2자기적인 절연층을 흡착하고, 그 다음에 상기 플렉스 전도체와 제2의 자기적인 절연층상에 전기적 절연층을 흡착하며 그 위에 자기성 전기 저항 소자를 제공하는 박막 자기 헤드 생산 방법으로서, 상기 제1의 자기적인 절연층은 상기 캐리어상의 전기적인 전도 플레이팅-베이스 흡착에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드 생산 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 플렉스 전도체는 전기 도금을 통해 플레이팅-베이스 상에 흡착되는 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드 생산방법.

청구항 3

제1항 또는 제2항에 있어서, 광래커 내식층은 플렉스 전도체가 흡착되기전에 플레이팅-베이스상에 흡착되며, 그 다음에, 적어도 상기 플렉스 전도체를 형성하기 위해 적어도 상기 광래커 벽층 부분 사이의 플레이팅 베이스상에 전기 도금되며, 다음에 상기 광래커 벽이 제거되는 것을 특징으로하는 박막 자기 헤드 생산방법.

청구항 4

제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서, 상기 제2의 자기적인 절연층은 적어도 상기 플렉스 전도체 사이의 플레이팅 베이스상에서 자기적 절연층은 전기적으로 전도시키는 전기 도금에 의한 흡착으로 형성되는 것

을 특징으로하는 박막 자기 헤드 생산방법.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기광래커 내식벽에 제거되기 전에 전기적 절연 차폐층은 적어도 플럭스 전도체상에서 흡착되며, 그 다음에 자기층 부분의 어셈블리, 차폐층 및 광래커 내식벽은 상기 플럭스 전도체가 거기에 남아 있는 차폐층 부분을 가지도록 구성되며, 그 다음 다른 광래커 내식벽은 플레이팅-베이스상에서 흡착되며, 다음에 적어도 상기 플럭스 전도체와 다른 광래커 내식벽 사이의 상기 제2자기 절연층 형성을 위한 전기적으로 전도하는 자기적 절연층은 전기 도금에 의해 흡착되며 그 다음에 상기 차폐층의 부분과 다른 광래커 내식벽이 제거되는 것을 특징으로하는 박막 자기 헤드 생산방법.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 플레이팅 베이스상의 자기층 부분의 흡착 동안에 다른 자기 보조층은 플럭스 전도체에 덧붙여 전기 도금에 의해 성장되며, 다음에 상기 자기층 부분과 상기 광래커 내식벽상의 차폐층은 상기에 흡착되며, 적어도 상기 플럭스 전도체 영역에서, 광래커 내식벽이 흡착되며, 다음에 상기 구조에서 또한 상기 광래커 내식벽이 제거되는 것을 특징으로하는 박막 자기 헤드 생산 방법.

청구항 7

선행항중 어떤 한 항에 청구된 바와 같은 방법에 따라 생산 가능한 박막 자기 헤드로서, 상기 자기 헤드는 자기 캐리어를 포함하며 상기 제1의 자기적 절연층은 상기 플럭스 전도체와 제2의 자기적인 절연층이 위치하는 곳에 존재하며, 상기 제2의 자기적인 절연층은 적어도 상기 플럭스 전도체 사이에 배열되며, 상기 전기적 절연층위의 자기성 전기 저항 소자는 플럭스 전도체와 제2의 자기적 절연층상에 위치되는 제2의 자기 절연층에 최소로 대응하여 존재하며, 상기 제1의 자기적 절연층은 전기적인 전도 플레이팅-베이스인 것을 특징으로하는 박막 자기 헤드.

청구항 8

제7항에 있어서, 상기 플레이팅-베이스는 Au를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드.

청구항 9

제7항 또는 제8항에 있어서, 상기 제2의 자기적인 절연층은 전기적인 전도 물질로 만들어진 것을 특징으로하는 박막 자기 헤드.

청구항 10

제9항에 있어서, 상기 제2의 자기적인 절연층은 전기 도금에 의해 얻어진 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드.

청구항 11

제9항 또는 제10항에 있어서, 상기 제2의 자기적인 절연층의 디멘존은 상기 플레이팅-베이스에 수직 방향으로 포함되며, 적어도 상기 플럭스 전도체와 거의 동일한 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드.

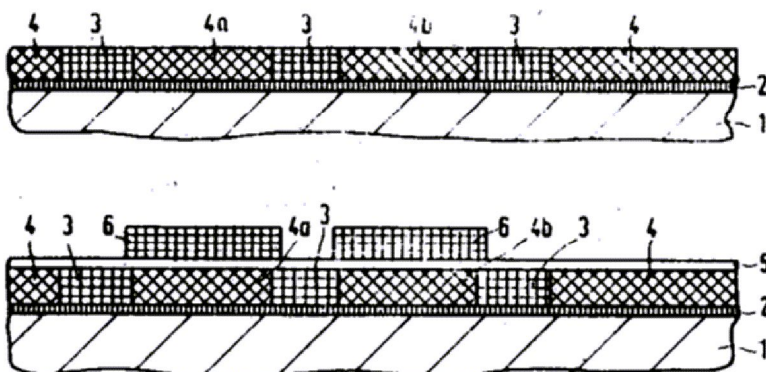
청구항 12

제9항, 제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 제2의 자기적인 절연층은 Cu를 포함하는 것을 특징으로 하는 박막 자기 헤드.

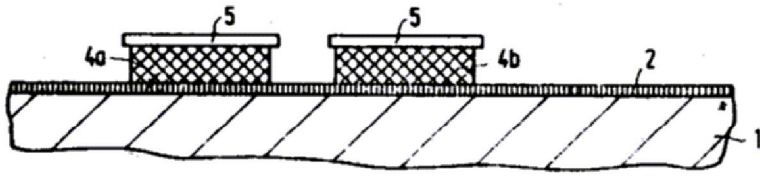
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3

